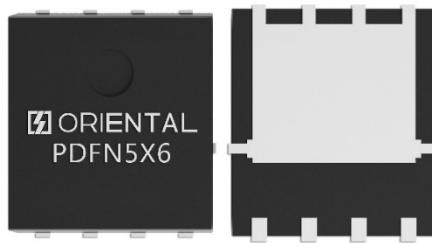




## PDFN5X6 封装型式

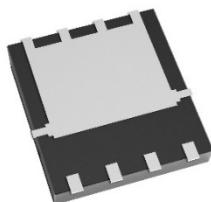
### 1、封装尺寸：

封装尺寸为 5mm×6mm，厚度约 0.95mm，属于紧凑型封装，适合对空间要求较高的应用场景，如汽车电子、消费电子等。



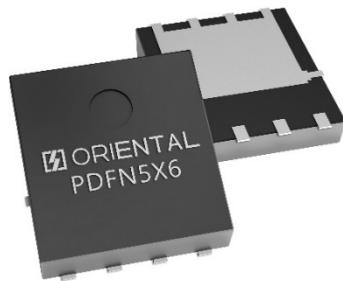
### 2、散热性能：

部分 PDFN5X6 封装采用双面散热设计，通过顶部和底部的散热金属层将芯片热量直接传导至外部，有效降低热阻，提升散热效率，尤其适用于高功率密度场景。



### 3、电气性能：

通常用于中低压功率 MOSFET 或 IGBT 等器件，具有低导通电阻 ( $R_{ds(on)}$ )、低栅极电荷 ( $Q_g$ )，支持高频开关，可降低导通损耗和开关损耗，提高系统能效。



#### 4、应用领域：

常见于汽车电子（如电池管理系统、车载充电器、电机驱动）、消费电子（快充、电源管理）、工业控制等领域，适用于需要高可靠性、高功率密度的场景。



#### 5、工艺特点：

采用铜夹片（Cu Clip）或铝线键合等工艺，结合顶部开窗设计，优化热流路径和电气连接，兼顾散热与信号传输性能。